

技术简讯

[1 / 5]

FA-CN-0470-A

MELSEC iQ-R系列基板的包装箱的变更通知

■出版年月

2025年10月

■相关机型

R33B、R35B、R38B、R312B、R35SB、R310RB、R310B-HT、R38RB-HT、R65B、R68B、R612B、R610RB、R68WRB、R610B-HT、R68RB-HT、R66WRB-HT、RQ65B、RQ68B、RQ612B

感谢您继续支持三菱电机MELSEC iQ-R系列可编程控制器。

关于MELSEC iQ-R系列基板的包装箱的变更，特此通知。

此外，与以往产品相比，产品的一般规格、性能规格及功能不会因本次变更而发生变更。

1 对象机型

对象机型如下所示。

品名	型号
主基板	R33B、R35B、R38B、R312B
超薄型主基板	R35SB
电源冗余用主基板	R310RB
支持高温主基板	R310B-HT
支持高温电源冗余用主基板	R38RB-HT
扩展基板	R65B、R68B、R612B
电源冗余用扩展基板	R610RB
冗余系统用扩展基板	R68WRB
支持高温扩展基板	R610B-HT
支持高温电源冗余用扩展基板	R68RB-HT
支持高温冗余系统用扩展基板	R66WRB-HT
RQ扩展基板	RQ65B、RQ68B、RQ612B

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA 461-8670, JAPAN

2 变更内容

2.1 包装箱尺寸

如下变更包装箱尺寸。

对象机型	变更前	变更后
R312B、R310RB、R310B-HT、R38RB-HT、R612B、R610RB、R68WRB、R610B-HT、R68RB-HT、R66WRB-HT、RQ612B	496 (W) × 137 (D) × 58 (H) [mm]	482 (W) × 137 (D) × 56 (H) [mm]
R38B、R68B、RQ68B	386 (W) × 137 (D) × 58 (H) [mm]	372 (W) × 137 (D) × 56 (H) [mm]
R33B、R35B、R35SB、R65B、RQ65B	304 (W) × 137 (D) × 58 (H) [mm]	290 (W) × 137 (D) × 56 (H) [mm]

2.2 材料构成与包装方法

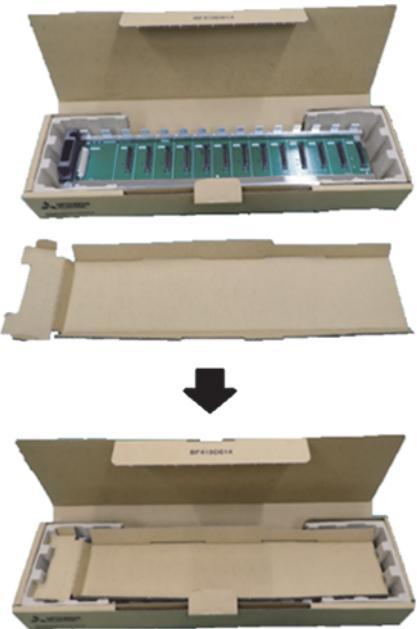
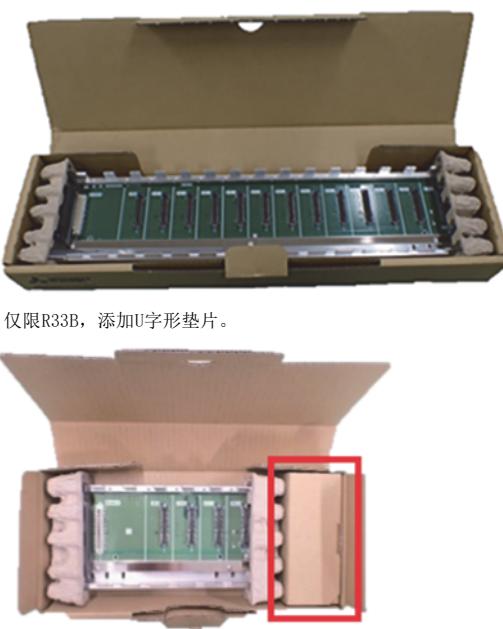
材料构成

如下变更材料构成。

对象机型	变更内容	变更前	变更后
全部机型	变更纸浆模塑形状		
	去除压板垫片		无
R33B	添加U字形垫片	无	

包装方法

如下变更包装方法。

对象机型	变更前	变更后
全部机型	<p>把产品放在纸浆模塑上，然后盖上压板垫片。</p>  <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>从两端将纸浆模塑嵌入产品。</p>  <p>仅限R33B，添加U字形垫片。</p> 

2.3 表记内容

如下变更包装箱的表记内容。

对象机型	变更内容	变更前	变更后
全部机型	删除系列名		
	添加回收标志		

3 变更理由

为了通过减少包装材料来减轻环境负荷。

4 变更时期

从2025年12月生产的产品开始依次替换。

此外，由于库存关系，在流通阶段新旧包装箱有可能同时存在。

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2025年10月	第一版

商标

The company names, system names, and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this technical bulletin.